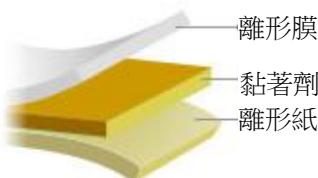


FPC D3410系列熱固膠帶

特點

- 可於FR4補強板或PI補強板呈現極佳的黏合強度。
- 低溫短時間固化，可縮短加工時間。
- 適合儲存於室溫環境中。
- 具初期微黏性，易於定位。
- 適用於各種加工程序，例如，傳壓機或真空快壓機及後續熟化。

結構



產品名稱	D3410	D3411
主要成份	NBR/環氧樹脂	NBR/環氧樹脂
基材	無基材	無基材
顏色	淡黃色	淡黃色
黏著劑厚度 (μm)	約35	約25
離形膜厚度 (μm)	約38	約38
離形紙厚度 (μm)	約115	約110
接著強度 (N/10mm) *	20	14
標準尺寸 (寬度及長度)	500mm x 100M	500mm x100M

* 90°剝離強度 (被貼物 :CCL/PI)

<建議壓著條件>

■ 真空快壓+熟化

壓合溫度：130~160°C

壓合時間：真空10~30秒>壓合1~2分鐘

壓力：1.5~2.0 MPa

熟化條件：140°C、60 min

■ 傳壓機：

壓合溫度：160°C

壓合時間：60 min

壓力：3 MPa

適合用途

- 適用於需經Reflow的FPC其補強板之固定用。

注意事項

① 烘乾程序

建議過Reflow前最好先進行烘乾處理，以防止爆板問題。

建議條件：100°C x 60 min以上

② 樣品在過Reflow前的放置條件：23°C x 65%RH, 3hr以內



技術性資料

1. 對各被貼物之接著強度 (90°剝離)

<測試件條件>

被貼物 : Glass Epoxy/Polyimide

膠帶寬度 : 10mm

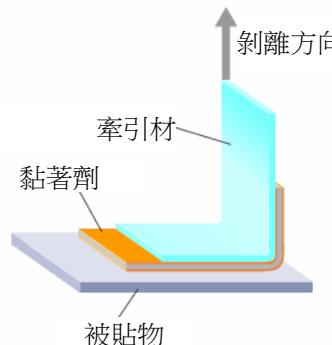
壓合條件 : 建議壓著條件

量測環境 : 23°C ± 5°C, 60% ± 20%RH

剝離速度 : 50mm/min

牽引材 : CCL (含銅箔)

[量測前先在室溫下放置1hr]



<90°剝離強度測試>

<結果>

(N/10mm)

90°剝離強度		D3410	D3411
傳壓機壓合	CCL/GE	21	17
	CCL/PI	15	13
真空快壓+熟化	CCL/GE	20	17
	CCL/PI	20	14

2. 耐Reflow特性

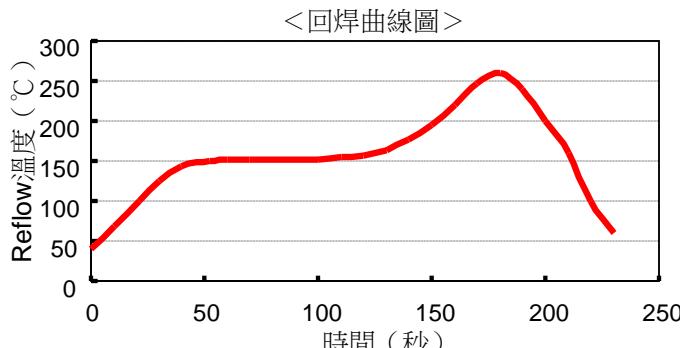
<樣品製作條件>

被貼物 : Polyimide film/CCL

壓合條件 : 建議壓著條件

Reflow條件 : 最高至260°C (請參照回焊曲線圖)

量測環境 : 23°C ± 5°C, 60% ± 20%RH



<實驗結果> *Reflow後進行外觀確認

壓合條件	預烘乾條件*	D3410	D3411
傳壓機壓合	1/100/-	無異狀	無異狀
真空快壓+熟化	1/100/-	無異狀	無異狀

*處理時間 (H) / 溫度 (°C) / 濕度 (%)

附註

- D3410系列的溢膠量，會隨著補強板之厚度、尺寸及形狀而不同，使用前請先進行確認。特別是在有開孔的補強板上使用時必須特別注意。



修版日期 : 2013年9月



特性資料附註 : 本型錄所述之產品特性資料，係根據本公司之評估結果而制訂，但不保證這些產品特性將符合使用環境之所需。因此，使用前應根據隨設備及底層所提供之評估資料而檢視相關之用途情況。

Dexteril Corporation

URL: <http://www.dexteril.jp/en/>

總公司 : Gate City Osaki, East Tower 8th floor, 1-11-2 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 141-0032 (日本東京)

業務及行銷部門／電話 : +81-3-5435-3946